

成都华微电子科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）坚信优化上市公司的运营质量，增强投资者的回报，增进投资者的满足感，乃上市公司成长的核心使命与义务。本着“以投资者为本”的发展宗旨，为保护所有股东的权益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在进一步优化公司的运营效能，增强市场竞争实力，确保投资者权利得到充分保护，并在资本市场中塑造良好的企业形象。具体行动措施包括：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向。公司承担了多项国家科技重大专项及国家重点研发计划，拥有数字和模拟类多品种的产品结构，通过不懈自主研发，公司已建立起完善的知识产权体系，公司核心产品 CPLD、FPGA 以及高精度 ADC 等在国内处于领先地位。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，并积累了良好的市场口碑。公司愿景是成为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨干力量，助力国家特种集成电路行业的长远发展。

2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

1、持续加大研发投入

公司所处的集成电路设计行业具有产品技术升级快、研发投入大等特点，公司将合理利用 IPO 募集资金投资“芯片研发及产业化”项目，深入开展高性能 FPGA、高速高精度 ADC、自适应智能 SoC 等三个方向的产品研发及产业化工作，巩固公司在 FPGA 领域的传统优势，继续推进公司高速高精度 ADC 领域的

快速发展，积极推动公司在智能 SoC 领域的突破。

公司处于特种集成电路行业，由于整体行业的最终应用场景及环境特征相较于其他领域更为复杂，对产品的性能要求更高、可靠性要求更为严格。通过使用募集资金实施“高端集成电路研发及产业基地”项目，公司将进一步提升公司集成电路产品测试和验证的综合实力，以满足公司日益增长的产品测试和验证需求。

此外，考虑到研发人员是技术突破和产品创新的基础和保障，公司不断完善研发管理机制及以期权和奖金为主的创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。

公司深耕特种集成电路领域，建立了完善的研发体系，高度重视对产品及技术的研发投入，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，在 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC 等领域承接了多项国家重点研发计划和科技重大专项，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队。公司将继续围绕高性能 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC 等领域，持续加大对研发投入，打造数模混合信号高端集成电路设计平台。未来几年，公司重点投入的研发内容与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能 FPGA	已形成五百万门到七千万门级 FPGA 谱系化产品；亿级大规模 FPGA 以及集成高速 ADC/DAC，CPU 和并行大规模 eFPGA 的高集成度 FPGA 产品和配套及 EDA 软件开发工具正在研发中。	集成高速 ADC/DAC、CPU 和信号处理定制加速单元，实现大带宽信号处理高性能处理平台。	国内领先	数据处理、5G 通信、卫星通信、人工智能加速等大带宽信号处理计算平台等领域。
2	高速数据转换 (ADC/DAC) 芯片	已形成 12 位 6GSPS 高速高精度 ADC 和 8 位 64G 超高速 ADC 等谱系化产品，且已实现小批量供货；单通道 12 位 12G 高速高精度 ADC 已经形成初样；4 通道 12 位 16G 高速高精度 ADC 和单通道 10 位 128G 超高速 ADDA 正在研发。	面向感知、测控、通信等宽频谱射频直采先进收发架构应用需求。	国际先进	电磁频谱、卫星激光通信，通感一体化，高端测控仪器仪表等领域。

3	智能异构系统 (SoC) 芯片	已完成一款智能异构 SoC 原型样片研制和测试, 突破智能加速处理器和并行大容量可编程架构设计等关键技术, 正在进行智能异构 SoC 量产产品的研发。	集成 CPU、GPU、NPU 以及 eFPGA 等核心 IP, 实现异构多核协同处理, 形成高效处理标量, 矢量和张量等多种计算的灵活高能比计算平台。	国内领先	机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域。
4	高精度数据转换 (ADC/DAC) 芯片	已完成一款 32bit 超高精度 ADC 产品研制, 突破了超低失调和大动态范围设计等关键技术, 正在进行更高采样率、更低噪声电压和集成可变增益放大器、可编程采样率和空间高可靠性设计等方面的扩展设计。	集成高阶调制器、可编程增益放大器、高精度基准源等可复用核心电路, 形成精度高、采样率和输入范围可配置的通用 AD 转换器产品。	国内领先	工业控制、陀螺、加速度计、热电偶、环境探测等领域。
5	微控制器芯片 (MCU)	已形成低功耗, 通用, 高性能的低中高全系列产品体系, 达到供货阶段, 正在研制超低功耗系列和高性能计算系列微控制器。	形成特殊集成电路最完整谱系产品, 高性能计算在微控制器领域应用落地。	国内领先	电机控制、车载等嵌入式控制领域。
6	电源管理芯片	已形成快速瞬态响应、超低噪声 LDO 电压调整器和高功率密度高效率 DC-DC 转换器谱系化产品, 实现批量供货。面向高速转换器供电的大电流 LDO 电压调整器产品和高功率高压智能驱动控制器产品正在研发。	面向高速通信和高速数据处理, 大功率智能驱动控制应用需求。	国内领先	高速通信、数据采集、伺服控制、精密测量等领域。
7	总线接口芯片	已形成 RS232/422/485 协议、245 总线、LVDS 等接口谱系化产品, 且已实现批量供货, 完成订过亿元。CAN 总线收发器、有源滤	开发 35KV 高等级 ESD 结构、宽电源域输入端口、高数据率驱动	国内领先	信号传输、通信系统、计算机系统等领域。

		波器多款典型产品已经定型并小批量供货。	器等设计,形成功能全面、应用灵活的接口产品库。		
--	--	---------------------	-------------------------	--	--

2、加强客户拓展

在长期的业务协作过程中,公司与下游合作伙伴建立了坚实的信任基础。在技术创新和产品研发方面,公司积极参与国拨项目产品开发及验证工作,力求与国际顶尖产品和技术保持同步,响应国内自主化趋势,不断向国际先进水平靠齐。同时,公司紧密跟踪客户的个性化需求,积极应对客户的反馈和市场变化,迅速调整研发策略,以提高研发效率,确保满足行业实际需求。此外,公司还致力于加强销售网络建设,组建了一支拥有丰富专业经验的技术支持团队,旨在为客户提供技术验证和应用服务支持,同时与研发部门通力合作,进一步深入挖掘客户需求,推动公司新产品和技术研发的进程。

3、关注集成电路设计行业合作与并购机遇

在高度竞争的产业形势下,公司在保障日常经营现金流动性需求的同时,关注与国内高端特种集成电路设计或验证测试厂商进行合作开发的机会,使公司能够覆盖更多的产品品类,占领更多细分市场,进一步为公司的长期可持续成长奠定基础。公司未来将重点聚焦和围绕特种集成电路设计、产品测试和验证产业布局机会,考虑对优质企业进行投资及并购,与公司在特种集成电路设计产业链实现协同发展,进一步提升公司的综合实力。

二、积极推进募投项目建设,提升公司科技创新能力

2024年2月,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,募集资金总额约为人民币15亿元。目前,IPO募集资金已逐步投入“芯片研发及产业化”与“高端集成电路研发及产业基地”募投项目。针对“芯片研发及产业化”项目,公司积极围绕高性能FPGA、高速高精度ADC、自适应智能SoC等三个方向的产品研发及产业化,具体投资于硬件购置、软件购置、人员工资等各项研发费用支出。同时,通过“高端集成电路研发及产业基地”项目的实施,公司将进一步建设检测中心和研发中心,打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台,强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。

2024 年，公司将会积极推进募投项目实施，并持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

1、提高经营效率

在销售回款方面，公司将定期对应收款管理效果进行评估，及时调整管理策略。此外，研发、市场等部门将通力合作，确保公司产品快速通过客户验证流程，提高资金使用效率，从而增强企业的市场竞争力和盈利能力。

在存货管理方面，鉴于过去两年供应链的紧张状况，公司适度增加了一些生产周期较长的原材料的库存量。随着供应链状况的逐步改善，公司将有序地减少这部分库存。同时，公司计划构建更为高效的库存管理体系，通过设定更为合理的库存警戒水平，促进存货的快速流转，以提高整体运营效率。

2、提高盈利质量

公司将持续进行市场拓展，以国内庞大的市场基础为依托，深入洞察并预测客户的未来需求，对产品线进行富有远见的战略部署和规划。此外，公司将加大力度开拓市场，紧跟全球集成电路设计领域的领先企业，专注于新产品的研发、新应用场景的探索以及新业务领域的开拓，旨在提升公司在特种集成电路市场的占有率，并不断优化公司的盈利能力。

3、提高资金效率

鉴于公司所在的集成电路设计领域资金需求高、技术更新迅速且研发活动往往先于市场应用，公司将高效利用资金资源，确保研发成果能够满足客户的潜在需求。为了提升资金使用效率，公司将实施一系列措施，包括优化库存管理、加速新产品在客户端的验证流程以及加快销售回款速度，以确保公司能够提升资金运用的效率并持续进行研发创新。

4、优化考核要求

公司在运营过程中实施了关键绩效指标的管理策略，针对在生产、物料、客户技术支持以及芯片性能等关键领域制定了一系列的评估标准，评估标准全面涉及了产品质量、检测效率和成本控制等多个维度。在 2024 年，公司将持续监控前述关键指标的执行情况，并通过分析数据和收集客户意见反馈进行内部审议，进而提出针对性的改进措施，并进一步优化关键绩效指标。

5、人力资源

公司持续致力于吸引和培育多领域的专业人才，并特别注重招募顶尖人才以提升团队的整体素质。公司将不断完善培训体系，强化员工的专业培训，构建一个高效的人才培育和职业发展平台。公司旨在通过结合内部培训、外部进修、专题研讨等多种方式，进一步提高员工的专业技能和综合素质。在支持员工追求个性化和差异化成长的同时，公司也将培养强烈的团队协作意识，以打造一支具有国际竞争力的顶尖团队，以支持公司的持续发展。此外，公司未来还将根据实际情况，对表现卓越的人才实施激励计划，将员工的个人利益与公司的长远利益紧密结合，以有效激发人才的潜力和创造力。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、推进各项制度的修订

公司将积极落实公司法修订、独立董事制度改革等相关意见，有序开展各项制度的修订工作。在已有董事会专门委员会制度的基础上，完善独立董事专门会议制度，充分发挥董事会及各专门委员会的职能和作用，使独立董事权责更匹配，职能更优化，监督更有力，提升董事会的专业化程度，保障董事会决策的科学性；同时公司将不断完善各项制度建设与修订，保证公司各项制度完整合规、有效可行，促进公司健康、可持续发展。

2、强化内部控制体系

公司将根据实际运营状况，对现有管理制度进行全面审视，并在满足内部控

制标准的基础上，创新管理方法，进一步完善建立适合公司特点的内部控制管理体系。公司将进一步明确各相关部门及人员的职责与权限，实施全面管理，鼓励全员参与，打造一个相互连接、相互监督的内部控制环境。

3、约束管理层行为

公司将督促董事会成员及高级管理人员恪守职责，对职务消费进行自我约束，避免无偿或以不公正的条件向第三方转移利益，不发生任何损害上市公司利益的行为，切实保护上市公司及所有股东的合法权益。

4、董监高专业培训

公司董监高将积极参与由证监会、上交所等监管机构组织的各类培训活动，加强对证券市场相关法律法规的学习，掌握证券市场知识，提升自我约束意识，促进公司持续规范运营。公司未来将持续支持董监高参与此类专业培训。

五、提升与投资者的互动与沟通

作为公司与投资者之间沟通的桥梁，董事会办公室自公司上市之日起便致力于建立和维护良好的投资者关系。通过主动接听投资者专线电话、迅速回复投资者的电子邮件以及积极参与“上证E互动”等平台的互动，公司始终致力于与投资者保持密切的联系。

展望未来，公司计划在每个季度、半年度及年度报告公布之际，利用“上证路演中心”等网络平台组织投资者沟通会议，详细阐释公司的经营成果，并对相关财务报告进行深入解读。公司将坚持遵守相关法律法规和监管要求，严格执行信息披露管理制度，确保所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。具体措施包括：

1、积极推动线上投资者互动

公司将持续通过“上证路演中心”、“全景网”等网络平台，在披露公司年报、半年报和季报后及时组织线上投资者交流会议，以保持与投资者的积极互动。

2、优化投资者反馈及意见征询流程

公司将不断改进投资者意见的征询和反馈流程，提升信息披露的透明度。通过深入了解投资者的需求和期望，并根据这些信息进行有效的沟通和反馈，公司

旨在确保投资者能够全面、及时地掌握公司的经营状况和发展战略，从而加强投资者对公司信任与支持。

六、持续完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。针对 2023 年度分红事宜，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 636,847,026 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,326,866.91 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 22.93%。公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。未来，公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司针对高级管理人员实施了与其经营绩效紧密相关的薪酬制度，主要包括固定薪资、基于业绩的年终绩效奖金和专项奖金三个部分。公司将根据每年的经营成果和盈利能力等关键绩效指标，并结合高级管理人员及所分管业务的 KPI 完成情况，对高管的年终绩效奖金和专项奖金进行评定。公司的 KPI 指标涵盖了销售业绩、订单量、利润率、客户拓展、生产规划、产品质量、研发进展、安全措施等多个方面，以全面评价公司的经营状况。高级管理人员个人 KPI 则依据每位高管的工作表现、完成的业绩目标等多方面因素进行综合评定。在 2024 年，公司将持续改进并坚定执行高管薪酬方案，以确保高管的薪酬结构与公司的经营表现保持一致，进一步激励高管团队为公司的长期发展贡献力量。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任

和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

成都华微电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日